



- Reaktives Fügen temperaturempfindlicher Materialien und solcher mit unterschiedlichen thermischen Ausdehnungskoeffizienten
- Beispiele: Silizium-Keramik, Glas-Metall und Hartmetall-Stahl, Diamant-Metall, etc.



MULTI-MATERIAL-VERBINDUNGEN



- Spannungsarmes reaktives Fügen eines mit einer optischen Beschichtung versehenen Siliziumwafers auf poröse oder wabenförmige Metallträger unter Nutzung von Lot, z. B. Laserscannerspiegel
- Punkt- und linienförmige Verbindungen realisierbar

LASERBEARBEITUNG



MIKROSYSTEMTECHNIK

- Hermetisch dichte und feste Verbindungen von Chips und Sensoren
- Elektrische und thermische Kontaktierung von Sensoren und Leistungselektronik
- Bonden von Siliziumwafern auf verschiedenste Substrate



AUTOMOTIVE



LEICHTBAU



VAKUUMBESCHICHTUNGSTECHNIK

■ Automatisierbares reaktives Fügen von Elastomer-basierten Türgummidichtungen

■ Stoffschlüssige Verbindung innerhalb von drei Sekunden

■ Flächenförmige Verbindung innerhalb weniger Sekunden

■ Hohe mechanische Festigkeit und Lebensdauer bei klimatischer Wechselbelastung

■ Langzeitstabile und hochleitfähige Verbindungen

■ Reaktives Fügen von unterschiedlichen Materialien, z. B. Bonden von Sputtertargets mit Silber auf Kupfer, unter Nutzung von Lot für Vakuumbeschichtungen

■ Stoffschlüssige Verbindung innerhalb von Lot für Vakuumbeschichtungen

■ Flächenförmige Verbindung innerhalb weniger Sekunden

■ Automatisiertes reaktives Fügen von Elastomer-basierten Türgummidichtungen

■ Stoffschlüssige Verbindung innerhalb von drei Sekunden

■ Flächenförmige Verbindung innerhalb weniger Sekunden

■ Hohe mechanische Festigkeit und Lebensdauer bei klimatischer Wechselbelastung

■ Langzeitstabile und hochleitfähige Verbindungen

■ Reaktives Fügen von faserverstärkten und -unverstärkten Kunststoffen in Sekundenbruchteilen

■ Feste Kunststoff-Metall-Hybridverbindungen realisierbar

Einfach unzertrennlich: Anwendungen des reaktiven Fügens



Simply Insert

- Reactive joining of temperature sensitive materials and those with different thermal expansion coefficients
- Examples: Silicon ceramics, glass-metal and carbide steel, diamond metal, etc.



MULTI-MATERIAL JOINTS

- Low-stress reactive joining of a silicon wafer provided with an optical coating on porous or honeycomb-shaped metal carriers using solder, e.g. laser scanning mirror
- Point- and line-shaped joints can be realized



LASER PROCESSING

- Hermetically sealed and tight joints of chips and sensors
- Electrical and thermal contacting of sensors and power electronics
- Bonding of silicon wafers to various substrates



MICROSYSTEMS TECHNOLOGY

- Automated reactive joining of elastomer-based door rubber seals
- Tightly bonded within three seconds
- Planar joint within a few seconds
- Long-term stable and highly conductive connections



fso_500-01

Comparable: Applications of Reactive Joining

- Bonding of sputtering targets, e.g. silver based targets on copper, using solder for vacuum coating
- Tightly bonded within three seconds
- High mechanical strength and lifetime under alternating climatic load



fso_500-01

AUTOMOTIVE INDUSTRY

- Bonding of sputtering targets, e.g. silver based targets on copper, using solder for vacuum coating
- Tightly bonded within three seconds
- Planar joint within a few seconds
- Long-term stable and highly conductive connections



fso_500-01

LIGHTWEIGHT CONSTRUCTION

- Bonding of sputtering targets, e.g. silver based targets on copper, using solder for vacuum coating
- Tightly bonded within three seconds
- Planar joint within a few seconds
- Long-term stable and highly conductive connections



fso_500-01

VACUUM COATING TECHNOLOGY

- Bonding of sputtering targets, e.g. silver based targets on copper, using solder for vacuum coating
- Tightly bonded within three seconds
- Planar joint within a few seconds
- Long-term stable and highly conductive connections



fso_500-01